

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成17年6月2日(2005.6.2)

【公表番号】特表2004-510970(P2004-510970A)

【公表日】平成16年4月8日(2004.4.8)

【年通号数】公開・登録公報2004-014

【出願番号】特願2002-532890(P2002-532890)

【国際特許分類第7版】

G 0 1 D 1/18

G 0 1 D 21/00

G 0 8 C 13/00

H 0 1 H 57/00

H 0 1 H 59/00

H 0 3 K 17/94

【F I】

G 0 1 D 1/18 Z

G 0 1 D 21/00 Z

G 0 8 C 13/00

H 0 1 H 57/00 Z

H 0 1 H 59/00

H 0 3 K 17/94 E

【手続補正書】

【提出日】平成15年8月13日(2003.8.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

適切には、このスイッチ開閉装置は、従来のマイクロメカニクスおよび／または半導体製造技術等の材料および方法に基づくマイクロリレー(M R)によってマイクロデバイスとして実現される。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0022】

マイクロリレーの高入力インピーダンスと制御回路・負荷回路間のガルバニ絶縁の結果、動作方向の反転は、回路図中の様々な位置にマイクロリレー(M R)を対応して挿入することによって、追加コンポーネントの必要なく、またはこの柔軟性を得るために他の配線構造の必要なく、簡単に行うことができる。従って、得られるセンサ装置のサブアセンブリのレイアウト費用および規模は、特に全コンポーネントをSMDとして構成できることから、最小限に抑えられる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0026】

(発明を実施するための最良の形態)

センサデバイスは、誘導センサ等の対応するトランスデューサを有し、出力回路を含む対応の適合または適応電子機器が関連付けられるサブアセンブリとして構成されるものと考えてもよい。この出力回路は最低1つの対応するスイッチ開閉装置を有し、これは好適にはマイクロリレー(M R)であり、後段の負荷回路の切換えを行う最低1つのスイッチ要素を有する。